

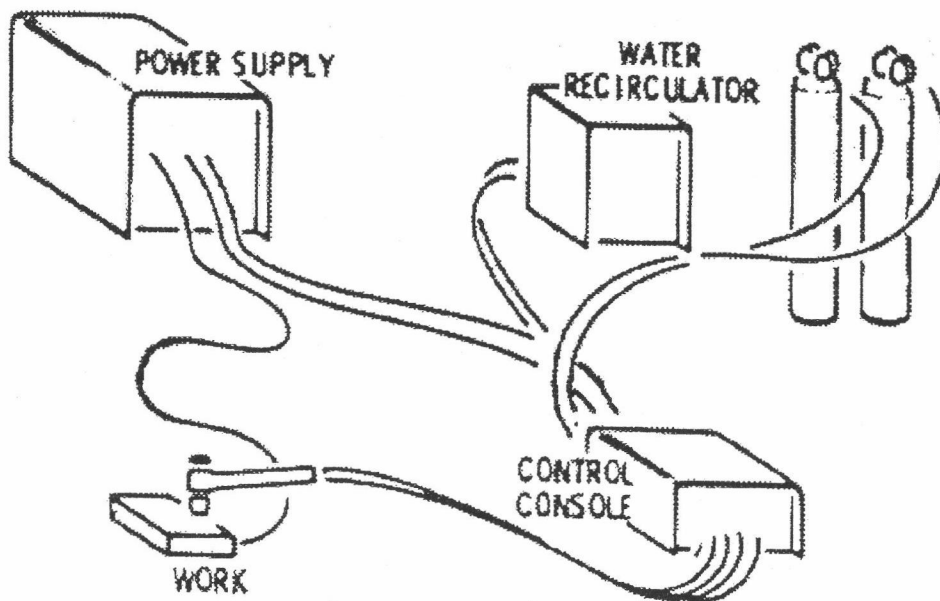
### บทที่ 3

#### การพัฒนาเครื่องไมโครอาร์คพลาสมา

##### 3.1 ข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบ

การผลิตพลาสมาอาร์คจะต้องมีองค์ประกอบของอุปกรณ์ตามแผนภาพในรูปที่ 3.1 ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญดังนี้

- 3.1.1 แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC power supply)
- 3.1.2 ส่วนควบคุมการเชื่อม (welding control console)
- 3.1.3 ระบบหมุนเวียนการจ่ายน้ำหล่อเย็น (recirculating water cooler)
- 3.1.4 หัวเชื่อมแบบไมโครอาร์คพลาสมา (micro plasma arc torch)
- 3.1.5 ระบบท่อแก๊สและระบบจ่ายแก๊ส (gas supplying system)
- 3.1.6 เครื่องรักษาระดับความดันแก๊ส (gas regulator)
- 3.1.7 ท่อส่งจ่ายระบบน้ำหล่อเย็น (cooling system)
- 3.1.8 เครื่องจุดอาร์คศักดาสูงความถี่สูง (arc ignition system)



รูปที่ 3.1 แสดงส่วนประกอบของระบบการเชื่อมแบบไมโครอาร์คพลาสมา

แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบสวิตช์ที่ต้องการในงานวิจัยนี้เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงที่สามารถควบคุมให้กระแสต้านออกคงที่โดยมีคุณสมบัติของเครื่องดังนี้

3.1.1 ด้านเข้ารับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V 50 Hz 1 เฟส

3.1.2 ด้านออกจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 80 V ขณะไม่มีโหลดและจ่ายกระแสขาออกสูงสุด 20 A

3.1.3 สามารถรักษาระดับกระแสต้านออกคงที่ได้ตั้งแต่ 0.5 - 20 A และสามารถปรับเปลี่ยนให้รักษาระดับกระแสคงที่ได้ต่อเนื่อง

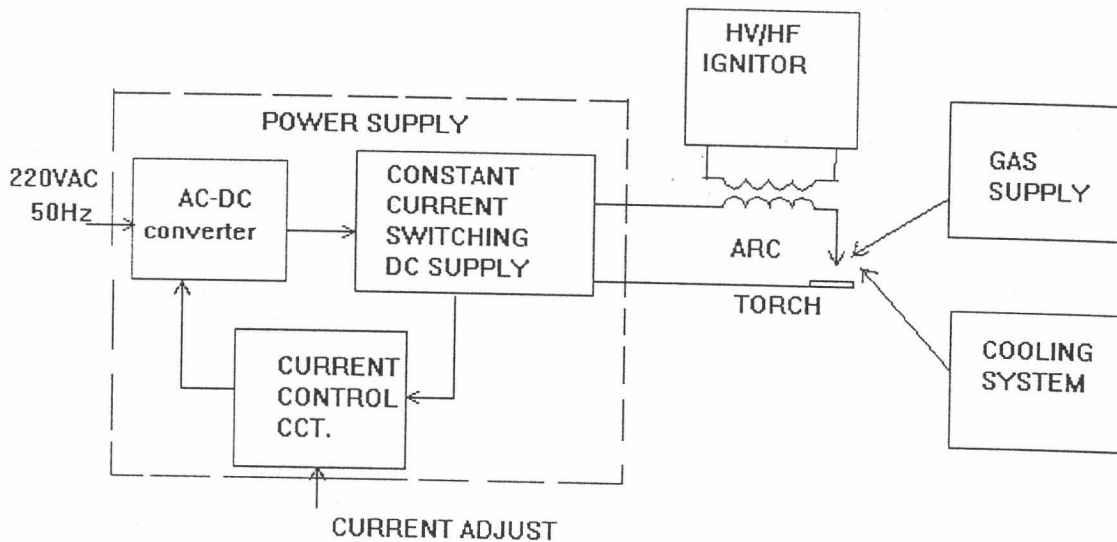
3.1.4 กำลังต้านออกประมาณ 1000 W

3.1.5 ระบายความร้อนของเครื่องด้วยพัดลมไฟฟ้า

3.1.6 มีระบบระบายความร้อนสำหรับหล่อเย็นหัวเชื่อมพลาสมา

### 3.2 การออกแบบเครื่องไมโครอาร์คพลาสมา

จากข้อมูลพื้นฐานในข้อ 2.1 สามารถออกแบบโครงสร้างการทำงานของเครื่องไมโครอาร์คพลาสมาได้ดังแผนภาพรูป 3.2 ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์หลัก 2 ส่วนคือ วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิดทางออกคงที่และวงจรจุดอาร์คเริ่มต้น ( pilot arc )

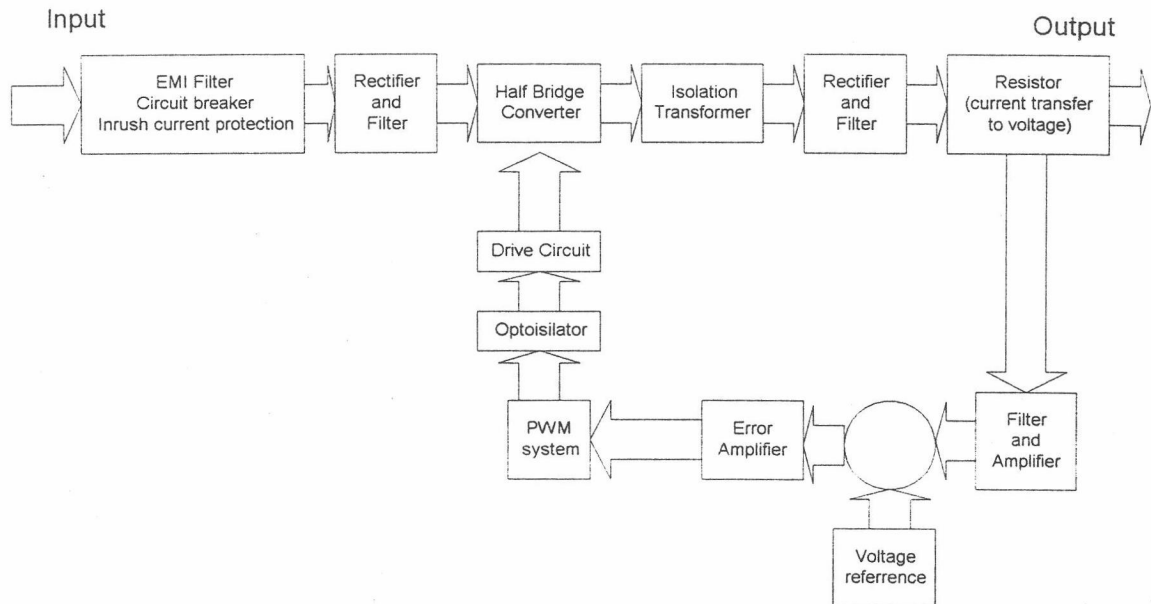


รูปที่ 3.2 โครงสร้างของเครื่องไมโครอาร์คพลาสมาที่พัฒนาขึ้น

การเกิดอาร์คพลาสมาเริ่มจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงไปยังหัวเชื่อมแบบอาร์คพลาสมาตามขนาดของกระแสที่ต้องการจากนั้นเปิดแก๊สอาร์คก่อนให้ไหลผ่านหัวเชื่อมในอัตราประมาณ 8 ลิตรต่อนาที<sup>[1]</sup> และจุดอาร์คเริ่มต้นด้วยวงจรกำเนิดศักดาไฟฟ้าสูงความถี่สูง ซึ่งจะทำให้แก๊สอาร์คก่อนเกิดไอออไนซ์และนำกระแสในช่วงแรกเกิดอาร์คเริ่มต้นหลังจากนั้นจะเกิดอาร์คหลักจากแหล่งจ่ายเต็มที่ได้ล้าพลาสมาจากหัวเชื่อม

### 3.3 การออกแบบวงจรจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบสวิตช์

จากข้อมูลความต้องการกระแสของไมโครอาร์คพลาสมาในข้อ 3.1 สามารถออกแบบวงจรจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบสวิตช์ชนิดกระแสทางออกคงที่ได้ดังในแผนภาพรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 แผนภาพโครงสร้างของของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบสวิตช์ของเครื่องไมโครอาร์คพลาสมา

การทำงานของวงจรจ่ายไฟฟ้าแบบสวิตช์ที่ออกแบบขึ้นมีดังนี้

ส่วนที่ 1 ด้านเข้ารับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V 50 Hz 1 เฟส เข้ามาผ่านวงจรกรองสิ่งรบกวน (EMI filter) และวงจรป้องกันการกระชากของกระแสเนื่องจากในวงจรกรองมีตัวเก็บประจุความจุสูงอยู่

ส่วนที่ 2 ไฟฟ้ากระแสสลับหลังผ่านวงจรส่วนแรกจะเข้าสู่วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ (bridge rectifier) เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V เป็นไฟฟ้ากระแสตรง 310 V และกรองพัลส์ตัดคาไฟฟ้าให้เรียบโดยตัวเก็บประจุความจุสูง

ส่วนที่ 3 วงจรสวิตช์จะจัดวงจรแบบครึ่งบริดจ์ (half bridge rectifier) โดยใช้เพาเวอร์มอดเฟต (power MOSFET) ชิ้นส่วนสวิตช์เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง 310 V เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 310 V (peak to peak) รูปคลื่นสี่เหลี่ยมความถี่ประมาณ 20 kHz

ส่วนที่ 4 เป็นวงจรลดศักดาไฟฟ้าโดยหม้อแปลงไฟฟ้าที่ทำงานที่ความถี่ใช้งาน 20 kHz ใช้หม้อแปลงที่ใช้แกนทำด้วยสารเฟอร์ไรท์ซึ่งออกแบบให้แปลงศักดาไฟฟ้าจาก 310 V<sub>p-p</sub> เป็น 80 V<sub>p-p</sub>

ส่วนที่ 5 เป็นวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์ (bridge rectifier) เพื่อเปลี่ยนศักดาไฟฟ้ากระแสสลับ 80 V<sub>p-p</sub> ความถี่ 20 kHz เป็นแรงดันกระแสตรง 80 V

ส่วนที่ 6 ตัวต้านทานต่ออนุกรมกับวงจรเพื่อตรวจจับกระแสที่ไหลผ่านทำหน้าที่แปลงกระแสเป็นศักดาไฟฟ้าป้อนกลับ (feedback)

ส่วนที่ 7 วงจรขยายศักดาไฟฟ้าที่ได้จากตัวต้านทาน นี้จะผ่านเข้าวงจรกรองสิ่งรบกวนเพื่อลดสัญญาณรบกวนและขยายให้มีขนาดใหญ่พอที่จะเข้าไปเปรียบเทียบกับศักดาไฟฟ้าอ้างอิงที่วงจรขยายศักดาคลาดเคลื่อน (error amplifier)

ส่วนที่ 8 วงจรกำเนิดศักดาไฟฟ้าอ้างอิงตั้งศักดาไฟฟ้าอ้างอิงค่าหนึ่งที่สูงกว่าศักดาที่มาจากวงจรขยาย ในสภาวะไม่จ่ายกระแส (no load) เพื่อใช้เปรียบเทียบกับศักดาไฟฟ้านั้นที่วงจรขยายศักดาคลาดเคลื่อน (error amp)

ส่วนที่ 9 วงจรขยายศักดาคลาดเคลื่อน (error amplifier) ทำหน้าที่เปรียบเทียบศักดาไฟฟ้าระหว่างศักดาไฟฟ้าอ้างอิงและศักดาไฟฟ้าป้อนกลับจากการแปลงกระแส การลัดวงจรที่วงจรทางออกจะทำให้ศักดาไฟฟ้าป้อนกลับที่เกิดจากกระแสไหลมีค่ามากกว่าศักดาไฟฟ้าอ้างอิง และนำค่าผลความคลาดเคลื่อนศักดาไฟฟ้าไปควบคุมวงจร PWM ทำการปรับความกว้างพัลส์ (pulse width) จนได้ศักดาไฟฟ้าป้อนกลับที่มาจากกระแสไหลเท่ากับศักดาไฟฟ้าอ้างอิง

ส่วนที่ 10 วงจรสร้างสัญญาณ pulse width modulation (PWM) ไปควบคุมวงจรสวิตช์ power MOSFET วงจรนี้จะสร้างสัญญาณความถี่ 20 kHz ในสภาวะ no load ที่มี duty cycle 40 % และมี 2 สัญญาณที่ทำงานสลับกันและในสภาวะที่มีโหลดมากหรือลัดวงจร สัญญาณนี้จะเปลี่ยนแปลงความกว้างของพัลส์ลงเพื่อควบคุมให้กระแสขาออกคงที่

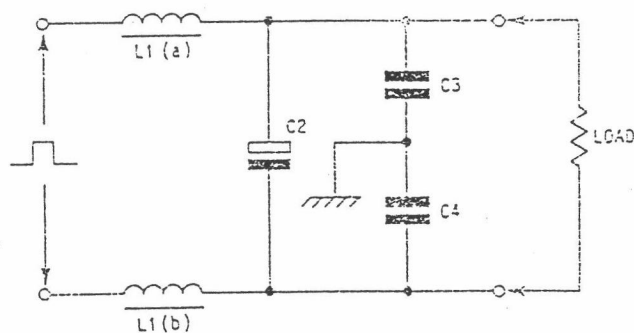
ส่วนที่ 11 วงจรส่งผ่านสัญญาณด้วยแสง (optoisolate) เป็นการแยกสัญญาณควบคุมออกจากด้านที่มีศักดาไฟฟ้าสูงเพื่อแยกกราวด์ของทั้ง 2 ส่วนออกจากกัน

ส่วนที่ 12 วงจรขับสัญญาณเป็นวงจรช่วยเพิ่มความแรงของสัญญาณควบคุมให้สูงเพียงพอที่จะขับ power MOSFET ได้ด้วยความเร็วสูง

### 3.3.1 การออกแบบวงจร EMI Filter ขนาดพิกัดของ Circuit Breaker และวงจรป้องกันการเกิดกระแสกระชาก

วงจร EMI filter (electromagnetic Interference filter) ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดจะมีวงจรตามรูปที่ 3.4 และมีพิกัดกระแสต่าง ๆ กันจากข้อมูลกระแสขาออกสูงสุด 20 A แรงดันขณะไม่มีโหลด 80 V แรงดันขณะจ่ายโหลดที่ 20 A ประมาณ 50 V ดังนั้น กำลังสูงสุด 1000 W ประมาณค่าประสิทธิภาพของเครื่อง 75 % ดังนั้น กำลังด้านเข้าสูงสุดคือ

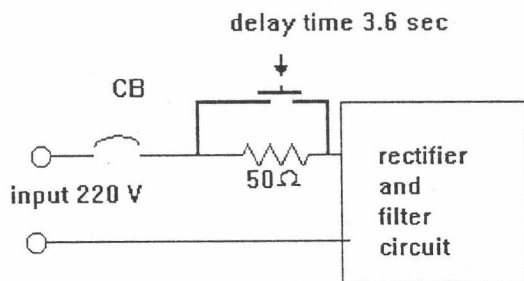
$\frac{1000W}{0.75} = 1334W$  กระแสด้านเข้าสูงสุดจะมีค่า  $\frac{1334W}{220V} = 6A$  ถ้าคิดค่า power factor เท่ากับ 1 ดังนั้นจึงเลือก EMI filter ที่มีพิกัดใกล้เคียงกับพิกัดกระแสด้านเข้าของวงจรซึ่งหาได้ค่าคือ 240 V กระแส 8 A



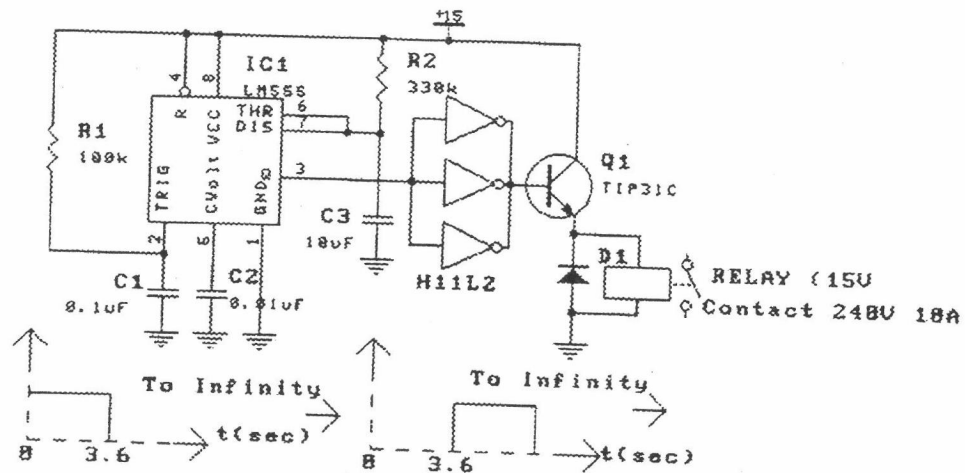
รูปที่ 3.4 วงจร EMI filter

circuit breaker ที่ใช้ป้องกันการลัดวงจรและใช้เปิดปิดวงจรเลือกใช้ที่มีพิกัดใกล้เคียงกับกระแสด้านเข้าคือ ใช้พิกัดกระแส 10 A พิกัดตัดค่าไฟฟ้า 220 V

วงจรป้องกันการเกิดกระแสกระชากเข้าตัวเก็บประจุกรองกระแสขณะเปิดวงจรจัดให้สวิตช์หน่วงในวงจรรูป 3.5 เปิดวงจรในช่วงแรกตั้งไว้ 4 วินาที ให้ผ่านความต้านทาน  $R_1$  เพื่อจำกัดกระแสตอนเปิดวงจร และหลังจาก 4 วินาทีจะทำการต่อวงจรตรงเพื่อเป็นการลดค่าความสูญเสียและให้วงจรทำงานเต็มพิกัดตัดค่าไฟฟ้าซึ่งวงจรป้องกันการเกิดกระแสกระชากเข้าตัวเก็บประจุแสดงในรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.5 วงจรป้องกันการเกิดกระแสกระชากเข้าตัวเก็บประจุกรองกระแส



รูปที่ 3.6 วงจร delay time 3.6 วินาที

การทำงานของวงจรหน่วงเวลา (delay time) เลือกใช้ไอซีเบอร์ LM555 ต่อวงจรแบบ monostable จะมีคาบเวลา เท่ากับ  $T$  ซึ่งคำนวณได้จากสมการที่ 3.1

$$T = 1.1R_T C_T \dots\dots\dots 3.1$$

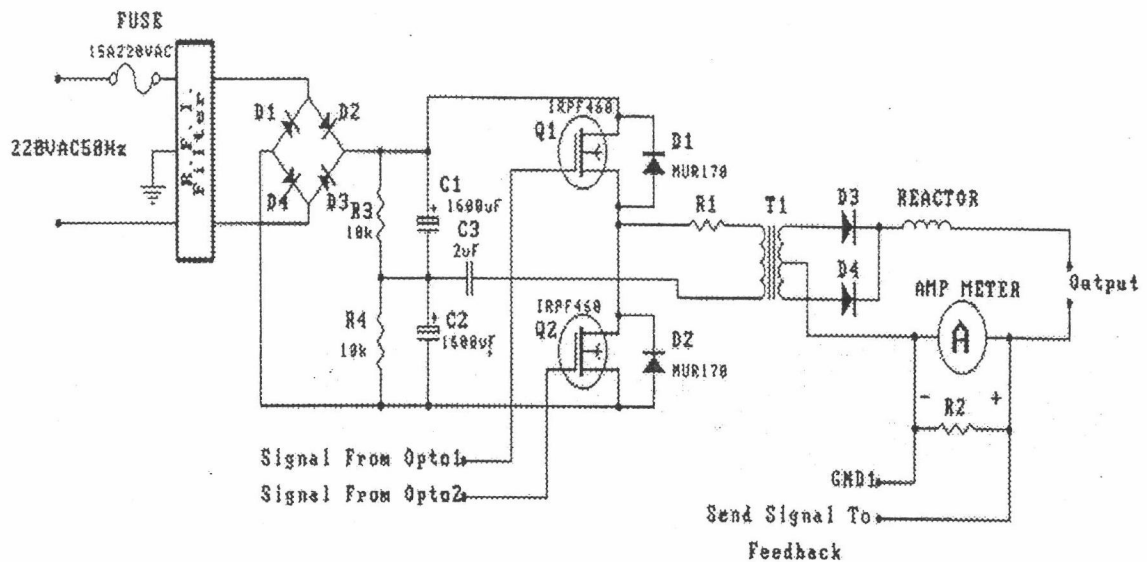
โดยที่  $R_T$  คือ ความต้านทานหน่วย โอห์ม

$C_T$  คือ ความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุหน่วยฟารัด

ต้องการให้หน่วงเวลาประมาณ 4 วินาทีจึงเลือก  $R_T$  เท่ากับ 330 กิโลโอห์ม และ  $C_T$  เท่ากับ  $10 \mu F$  ดังนั้นคำนวณเวลาที่ LM 555 กำเนิดพัลส์รูปเหลี่ยมได้เท่ากับ  $T = 1.1 \times 330 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-6} = 3.6$  วินาทีเมื่อจ่ายไฟฟ้าเข้า LM 555 จะส่งพัลส์ 15 V มีความกว้างพัลส์ 3.6 วินาทีผ่านอินเวอเตอร์ H11L2 เพื่อกลับสัญญาณและขับวงจรเบสของทรานซิสเตอร์ทำให้ทรานซิสเตอร์ TIP 31C นำกระแสและรีเลย์จะดึงหน้าสัมผัสสวิตช์ให้ปิดวงจรในเวลา 3.6 วินาที

### 3.3.2 การออกแบบวงจรเรียงกระแสและกรองกระแส

จากการคำนวณกระแสต้านเข้าสูงสุดในข้อที่ 3.3.1 ได้ 6 A และขณะเริ่มเปิดเครื่องจะเกิดกระแสกระชากเนื่องจากตัวเก็บประจุกรองกระแส ดังนั้นจึงเลือกไดโอด ( D1- D4 ) เพื่ออัตราทนกระแสไว้ที่ค่า 35 A ตักดาไฟฟ้ากลับทาง 400 V และจัดวงจรไฟฟ้าแบบบริดจ์ได้ตัว วงจรจ่ายกำลังไฟฟ้าในรูปที่ 3.7 เลือกไดโอดบริดจ์เบอร์ KBPC3504



รูปที่ 3.7 วงจรจ่ายกำลังไฟฟ้า

ค่าความจุของตัวเก็บประจุคำนวณได้จากสมการที่ 2.3  $C = \frac{It}{\Delta V}$  โดยประมาณกำลังไฟฟ้าของเครื่องเท่ากับ 1000 W ประสิทธิภาพของเครื่อง 75 % ตักดาไฟฟ้าต้านเข้า 220 V 50 Hz จากการคำนวณจะได้กำลังต้านเข้า  $P_{in}$  เท่ากับ 1334 W กระแส 6 A ถ้ากำหนดให้ ripple voltage มีค่าเท่ากับ 50 V จะได้ค่าความจุของตัวเก็บประจุ

$$C = \frac{6(10 \times 10^{-3})}{50} = 1200 \mu F$$

จากวงจร half bridge ทำการต่อตัวเก็บประจุ อนุกรมกัน 2 ตัวดังนั้นตัวเก็บประจุ แต่ละตัวมีขนาด  $1200 \mu F$  แต่ไม่สามารถหาได้ จึงใช้ ตัวเก็บประจุ ที่มีค่า  $1600 \mu F$  แทน โดยสามารถรับศักดากระแสตรงได้ 400 Vdc

เนื่องจากตามมาตรฐานของ วสท. 408 กำหนดให้ตัวเก็บประจุที่ใช้กับแรงดันไม่เกิน 600 V จะต้องมีความต้านทานต่ออยู่เพื่อช่วยให้ตัวเก็บประจุคายประจุให้แรงดันลดลงเหลือ 50 V ภายใน 1 นาที ค่าความต้านทานหาได้จากสมการ

$$V_c = 1.1 \times V_{DC} \times EPX^{-60/RC} \dots\dots\dots 3.2$$

$$\text{แทนค่า } V_{DC} = 155 \text{ Volts}$$

$$V_c = 50 \text{ Volts}$$

$$C = 1600 \mu F$$

จะได้  $R = 30.6 \text{ k } \Omega$  เนื่องจากความต้านทานที่ทนกำลังไฟฟ้าสูงมีค่าจำกัดจึงเลือกใช้  $10 \text{ k } \Omega$  กำลังไฟฟ้าที่ได้รับมากที่สุด 2.4 W เลือกใช้แบบกระเบื้องที่มี ค่า 5 W

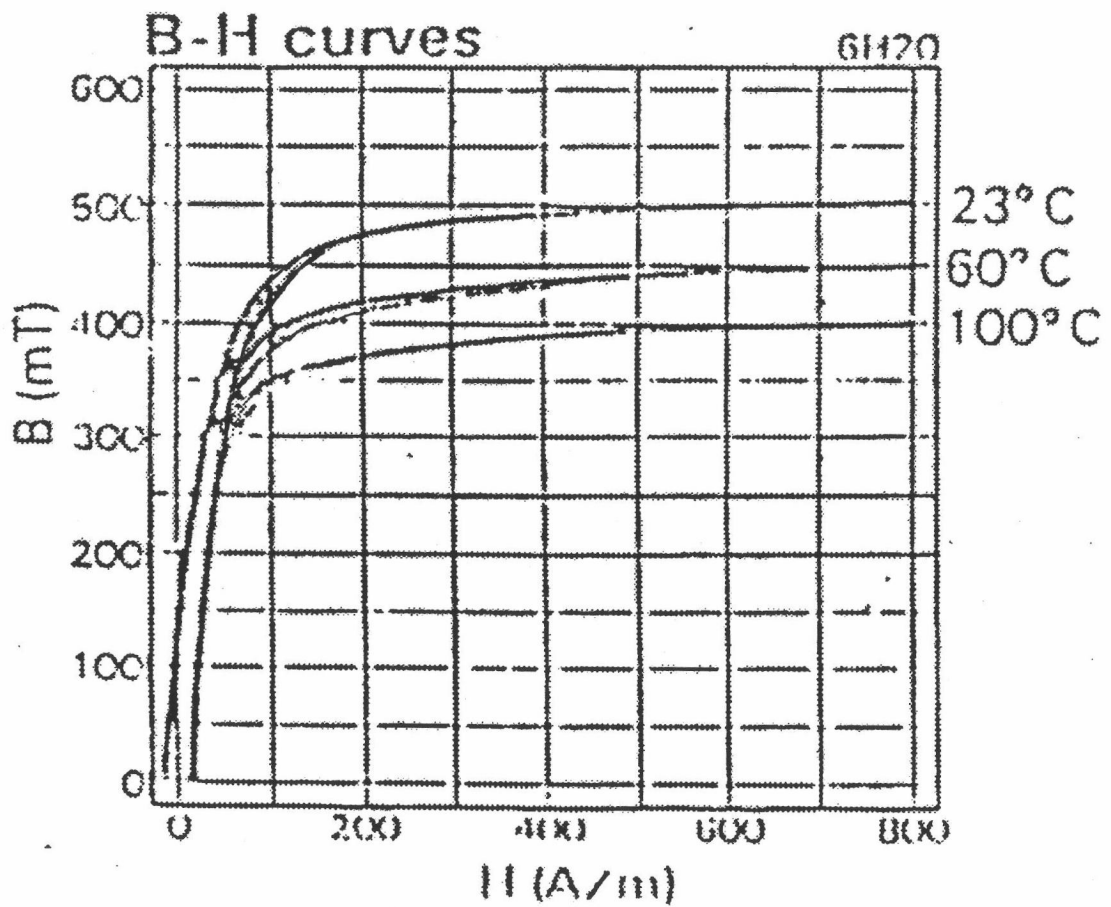
### 3.3.3 การเลือกชิ้นส่วนกำลังในวงจรสวิตช์

จากคุณสมบัติชิ้นส่วนทรานซิสเตอร์กำลังในตารางที่ 2.2 จะเห็นว่าชิ้นส่วนที่ใช้เป็นสวิตช์ความถี่สูงได้ดีสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง IGBT และ power MOSFET เนื่องจาก power MOSFET สามารถหาได้ง่ายกว่าจึงเลือกใช้ power MOSFET ที่รับกระแสได้ 13 A ศักดาไฟฟ้า  $V_{DS(max)}$  500 V ดั๊กเกตเบอร์ IRFP 460 (รายละเอียดในภาคผนวก ก.) , และขนาดสายไฟฟ้าที่ใช้ในวงจรด้านขดปฐมภูมิซึ่งรับกระแสสูงสุดไม่เกิน 13 A เลือกใช้ขนาด  $2.5 \text{ mm}^2$  และด้านขดทุติยภูมิรับกระแสสูงสุดไม่เกิน 25 A จึงเลือกขนาดของสาย  $6 \text{ mm}^2$



### 3.3.4 การเลือกแกนเฟอร์ไรท์ของหม้อแปลง

แกนเฟอร์ไรท์ที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถหาได้คือแกนแบบ EE 80/76 มีความสามารถรับพิกัดกำลังได้ประมาณ 700 W (รายละเอียดในภาคผนวก ข) ที่ความถี่ 20 kHz จึงใช้แกนแบบนี้ 2 แกนรวมกันและจากค่าความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กที่เลือกจะใช้ค่าประมาณครึ่งหนึ่งความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กอิ่มตัว ( $B_{sat}$ ) เพื่อป้องกันการอิ่มตัวของแกน จากรูปที่ 3.8 จะได้ B ประมาณ 200 mT



รูปที่ 3.8 แสดง B-H curve ของแกนเฟอร์ไรท์แบบ EE80/76 ชนิด 6H20

การคำนวณหารอบของขดลวด

ก) คาบเวลาการทำงาน

$$T = 1/f$$

$$= \frac{1}{20 \times 10^3} = 50 \mu s$$

ข) คำนวณหาเวลานำกระแส

$$T_{on (Max)} = 0.8 (T/2) = 0.4 T$$

$$T_{on (Max)} = 0.4 T$$

$$= 0.4 \times 50 \times 10^{-6}$$

$$= 20 \mu s$$

ค) คำนวณหาจำนวนรอบขดปฐมภูมิ ( $N_p$ ) จากสมการ 2.8

$$N_p = \frac{V_p \times t_{on}}{\Delta B \times A_{cp}}$$

แกนแบบ EE80/76 2แกนรวมกันมีพื้นที่หน้าตัด  $754 \text{ mm}^2$  จะได้

$$N_p = \frac{155 \times 20}{200 \times 10^{-3} \times 754} = 20.54 \quad \text{รอบ}$$

ดังนั้นเลือกใช้  $N_p = 21$  รอบ

ง) คำนวณหาจำนวนรอบขดทุติยภูมิ ( $N_s$ )

ศักดาไฟฟ้าที่ด้านทุติยภูมิต้องการใช้  $80 \text{ V}$  แต่เพื่อค่าไว้  $85 \text{ V}$

$$N_s = N_p \times \frac{V_s}{V_p} = 21 \times \frac{85}{155} = 11.5 \quad \text{รอบ}$$

ดังนั้นเลือกใช้  $N_s = 12$  รอบ

ถ้าต้องการให้ด้านทุติยภูมิมีศักดาไฟฟ้าออกมา  $160 \text{ V}_{pp}$  และมีแทปกกลางตรงกลางเพื่อวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นซึ่งใช้ไดโอด 2 ตัว  $N_s = 24$  รอบ

### 3.3.5 การออกแบบวงจรจ่ายกระแสต้านออก

เนื่องจากกระแสทางออกมีความถี่สูง ดังนั้นไดโอดเรียงกระแสต้านออกควรใช้ชนิด ultrafast recovery ซึ่งมีพิกัดอัตราคักตาไฟฟ้าและกระแส 200 V 50 A เนื่องจากหาไม่ได้จึงใช้ชนิด superfast recovery แทนใช้เบอร์ IR 60 HFU-400 ซึ่งสามารถทนคักตาไฟฟ้าได้ 400 V และนำกระแสได้ 60 A ที่ 82 °C มี recovery time 60 ns และขดลวดทางออกของวงจรคำนวณได้จาก

$$L = \frac{E_{out} t_{off}}{0.25 I_{out}} \dots\dots\dots 3.3$$

โดย  $t_{off}$  คำนวณได้จาก

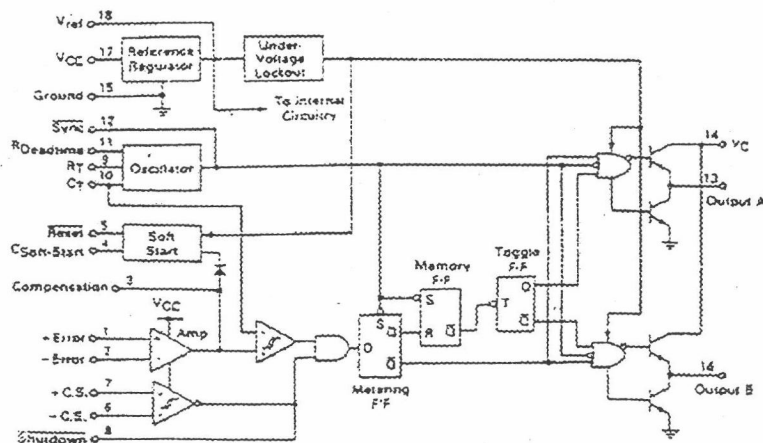
$$t_{off} = \frac{1 - \left( \frac{E_{out}}{E_{in}} \right)}{2 f} = \frac{1 - \left( \frac{80}{90} \right)}{40 \times 10^3} = 2.78 \mu s$$

แทนค่า  $t_{off}$  ,  $E_{out}$  และ  $I_{out}$  ในสมการ 3.3 จะได้

$$L = \frac{80 \times 2.78}{20} = 11.12 \mu H$$

### 3.4 การออกแบบวงจรควบคุมกระแสต้านออก

การควบคุมกระแสทางออกของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบสวิตช์ใช้การควบคุมความกว้างของพัลส์ของความถี่ที่กำเนิดขึ้นเพื่อขับ power MOSFET ซึ่งการควบคุมความกว้างของพัลส์จากการป้อนกลับของสัญญาณคลาดเคลื่อนที่ตรวจพบจากการเปรียบเทียบนี้เรียกว่า "pulse width moderation PWM" ปัจจุบันมีการผลิตไอซีสำเร็จรูปทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะ ได้แก่ ไอซีเบอร์ SG 3524 , SG 3525 และ SG 3526 ในวงจรนี้เลือกใช้ไอซีเบอร์ SG3526 รายละเอียดในภาคผนวก ค. เนื่องจากจะต้องทำงานร่วมกับวงจรขับที่มีคักตาไฟฟ้าสูงจึงต้องจัดวงจรแยกกราวด์ของวงจรควบคุมและวงจรขับออกจากกันซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ชิ้นส่วนในการแยกกราวด์ เช่น pulse transformer หรือ optoisolator เป็นต้น โครงสร้างภายในของวงจรนี้แสดงในรูปที่ 3.9

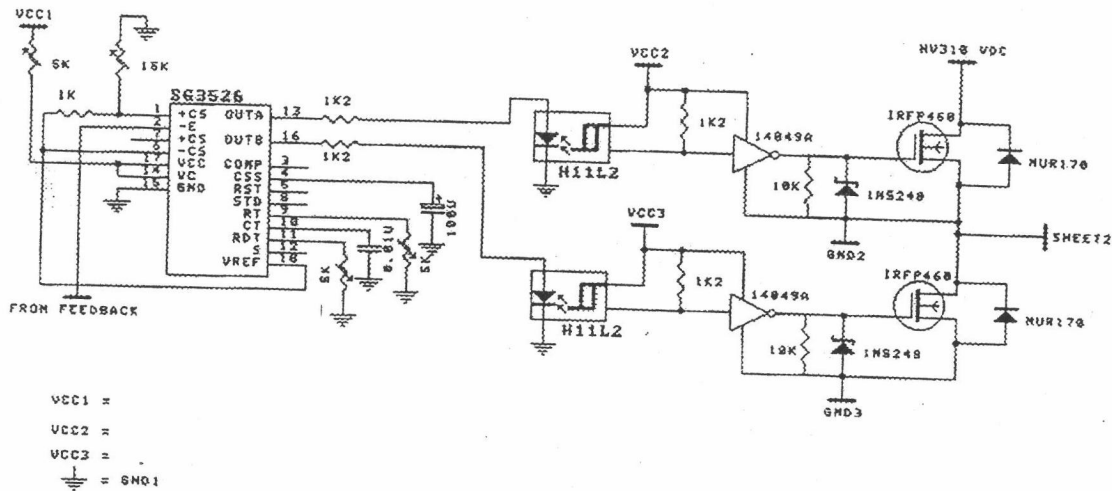


รูปที่ 3.9 โครงสร้างภายในของไอซี SG3526

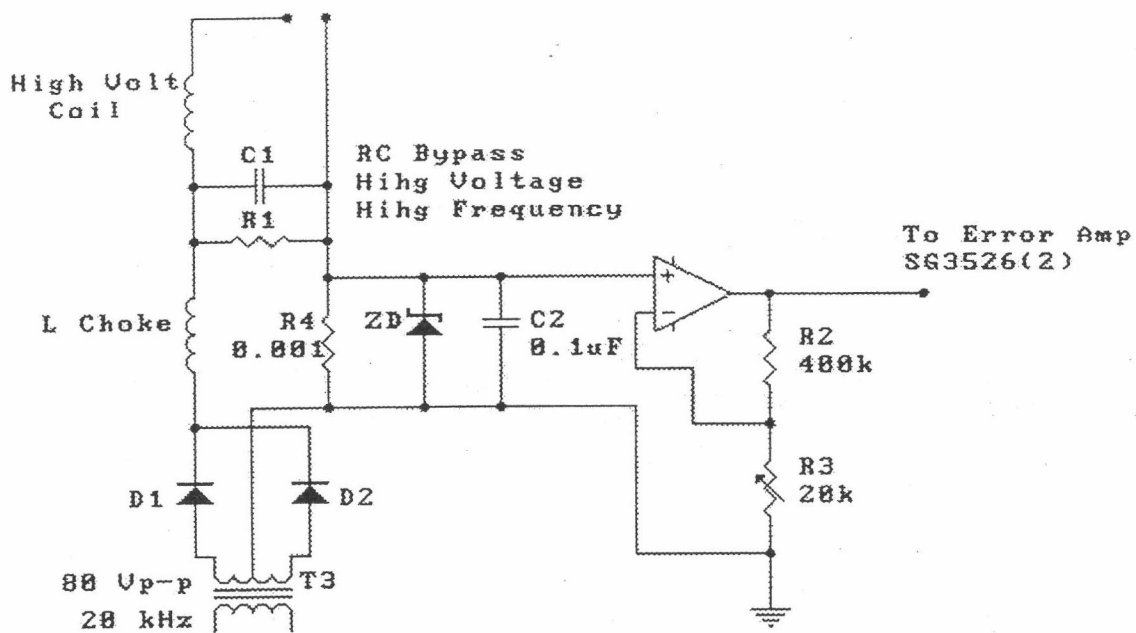
การใช้ไอซี PWM เบอร์ SG3526 ช่วยให้การสร้างวงจรย่อยหลายส่วน เนื่องจากภายในโครงสร้างมีวงจรถ้าเหน็ดความถี่สวิตช์ วงจรจัดการควบคุมช่วงเวลานำกระแสของชิ้นส่วนสวิตช์ วงจรสร้างศักดาอ้างอิงและวงจรถยายระดับศักดาคลาดเคลื่อน (error amplifier) ซึ่งจะรับระดับศักดาไฟฟ้าป้อนกลับที่เป็นสัดส่วนกับกระแสทางออกมาเปรียบเทียบกับศักดาไฟฟ้าอ้างอิงและควบคุมความกว้างของพัลส์ผ่านวงจบบแยกกวางนด

ในรูปที่ 3.10 เป็นวงจรถวลคุมกระแสทางออกที่ออกแบบขึ้นโดยใช้ไอซี SG3526 สัญญาณทางออกที่ขา 16 และขา 14 จะขับ power MOSFET Q<sub>1</sub> และ Q<sub>2</sub> ผ่านวงจบบแยกกวางนดซึ่งเลือกใช้แบบ optoisolator ที่ U<sub>1</sub> และ U<sub>2</sub> เป็นไอซีเบอร์ H11L2 การปรับกระแสของแหล่งจ่ายปรับจากรฐานเริ่มต้นของความกว้างพัลส์ที่ V<sub>R</sub> 5 kΩ ที่ขา 11 ของไอซี SG3526

การควบคุมกระแสทางออกให้คงที่ใช้ความต้านทานแปลงค่ากระแสทางออกมาเป็นศักดาไฟฟ้าที่เป็นสัดส่วนกับกระแส ป้อนกลับมาเปรียบเทียบกับศักดาไฟฟ้าอ้างอิงของไอซี SG3526 ที่ขา 2 เพื่อให้วงจรถวลคุมปรับความกว้างของพัลส์ที่ขับ Q<sub>1</sub> และ Q<sub>2</sub> ให้ได้กระแสทางออกคงที่ตามต้องการดังในวงจรรูปที่ 3.11



รูปที่ 3.10 วงจรถวลคุม



รูปที่ 3.11 วงจรแปลงกระแสไฟฟ้าเป็นศักดาไฟฟ้าป้อนกลับเพื่อควบคุมกระแสให้คงที่

จากวงจรค่าความต้านทานป้อนกลับคำนวณได้จากสัดส่วนของกราฟแปลงกระแสเป็น ศักดาไฟฟ้าค่าสูงสุดที่ 30 mA , 30 mV ดังนั้นค่าความต้านทานจะมีค่า

$$R = \frac{V}{I} = \frac{30mV}{30A} = 1m\Omega$$

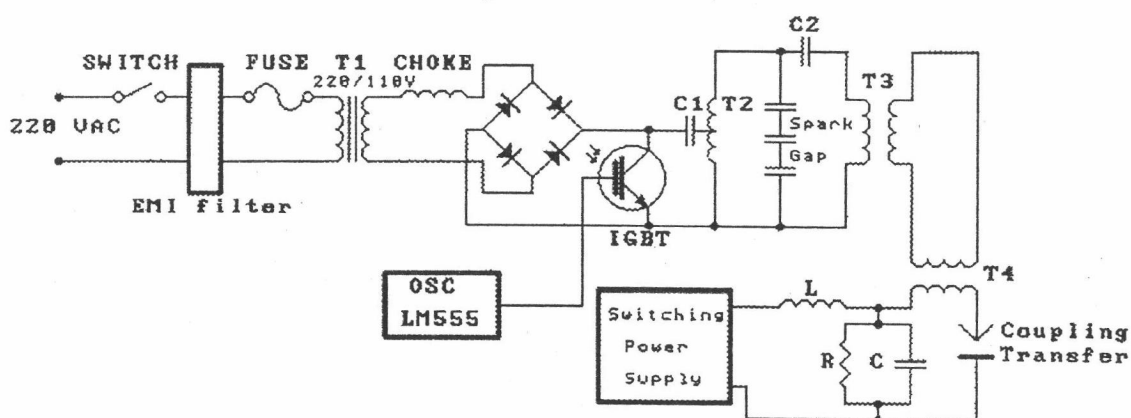
เนื่องจากศักดาไฟฟ้าอ้างอิงที่ ไอซีควบคุม SG 3526 ปรับได้ที่ค่า 0.63 V แต่วงจร แปลงกระแสเป็นศักดาไฟฟ้า สามารถแปลงศักดาไฟฟ้าได้สูงสุด ( $V_{feedback}$ ) ได้เท่ากับ  $I \times R = 30 \times 0.001 = 0.03V$  ดังนั้นจึงต้องการอัตราขยายเท่ากับ  $0.63/0.03=21$  เท่า ใน วงจรจึงใช้วงจรขยายแบบไม่กลับสัญญาณซึ่งมีอัตราขยาย

$$A_v = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = \frac{400k + 20k}{20k} = 21 \text{ เท่า}$$

โดยที่ทางออกของวงจรใช้ไดโอดซีเนอร์ ไว้ป้องกันศักดาไฟฟ้าเกินและใช้ตัวเก็บประจุ ใ้กรองสิ่งรบกวนขณะเชื่อมไม่ไห้รบกวนการควบคุมกระแสของไอซี PWM

### 3.5 การออกแบบระบบจุดอาร์คด้วยศักดาไฟฟ้าสูงความถี่สูง

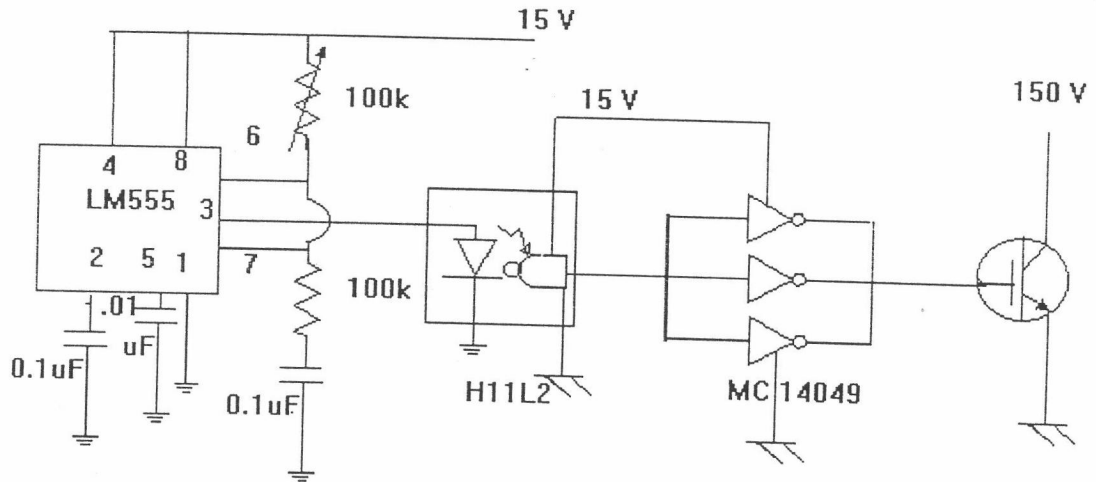
การกำเนิดอาร์คพลาสมาจำเป็นต้องมีการเริ่มต้นอาร์คไฟฟ้าให้เกิดการไอออไนซ์ของแก๊สเพื่อสร้างภาวะนำกระแสของแก๊ส ในการพัฒนาเครื่องไมโครอาร์คพลาสมาเลือกใช้การจุดอาร์คด้วยศักดาไฟฟ้าสูงความถี่สูง ซึ่งตามปกติจะใช้ศักดาไฟฟ้าประมาณ 1 - 5 kV ที่ความถี่สูงมากกว่า 1 MHz เนื่องจากอาร์คแบบไมโครนี้มีกระแสต่ำการรักษาวงจรพลาสมาให้เกิดได้ต่อเนื่องจะต้องใช้ศักดาไฟฟ้าสูงผสมกับแหล่งจ่ายกระแสต่อเนื่องจึงได้ออกแบบระบบจุดอาร์คที่มีขนาดเล็กและทำงานได้ต่อเนื่อง ด้วยการประยุกต์ใช้คอยล์จุดระเบิดเครื่องยนต์ (ignition coil) ของเครื่องยนต์มาสร้างเป็นวงจรกำเนิดศักดาไฟฟ้าสูงและกำเนิดความถี่สูงที่ศักดาไฟฟ้าสูงด้วยคอยล์เทสลา (Tesla coil) ด้วยวงจรในรูปที่ 3.12



รูปที่ 3.12 วงจรสร้างศักดาไฟฟ้าสูงความถี่สูง

#### 3.5.1 การออกแบบวงจรกำเนิดไฟฟ้าศักดาสูง

วงจรกำเนิดไฟฟ้าศักดาสูงเลือกใช้ไอซีเบอร์ 555 เป็นวงจรกำเนิดสัญญาณรูปเหลี่ยมที่มี duty cycle ประมาณ 50% ขับวงจรสวิตช์ด้วย IGBT ขนาด 600 V 30 A ผ่านไอซี optoisolator และเกตกลับสัญญาณ MC 14049 ใช้ศักดาไฟฟ้ากระแสตรงในวงจรสวิตช์ 150 V ดังแสดงในรูปที่ 3.13 ทำการสร้างศักดาไฟฟ้าสูงจากคอยล์จุดระเบิดเครื่องยนต์ทำงานด้วยกระบวนการคายประจุจากตัวเก็บประจุ (capacitor discharge) โดยจัดวงจรสวิตช์ IGBT ให้เก็บประจุผ่านโชค (choke) L1 และคายประจุผ่าน IGBT ขณะรับสัญญาณจากไอซี 555 ดังในรูปที่ 3.12



รูปที่ 3.13 วงจรสร้างสัญญาณควบคุม IGBT

ก. การคำนวณหาค่าขึ้นส่วนประกอบการทำงานที่ความถี่ของไอซี 555 เนื่องจากคอยล์จุดระเบิดเครื่องยนต์ทำงานที่ความถี่ไม่เกิน 100 Hz ดังนั้นจึงเลือกความถี่ที่ทำงานเท่ากับ 75 Hz และคำนวณหาค่า  $R_B$  จากสูตร 3.3

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1.44}{(R_A + 2R_B)C} \text{ Hz} \dots\dots\dots 3.3$$

โดยเลือกค่า  $C = 0.1 \mu\text{F}$  และให้  $R_A = 0.1 \text{ M}\Omega$  ดังนั้นค่า  $R_B$  จะมีค่า

$$75 = \frac{1.44}{(0.1 + 2R_B)0.1}$$

$$R_B = \frac{1}{2} \left( \frac{1.44}{75} - 0.1 \right) = 0.092 \text{ M}\Omega$$

ในวงจรจึงเลือกใช้ความต้านทานปรับค่าได้ค่า 100 K $\Omega$  ปรับค่าให้วงจรกำเนิดความถี่ได้ 75 Hz ขา 3 ของวงจรถัดความถี่จะขับ LED ภายในไอซี optoisolator ส่งสัญญาณผ่านไปยังไอวีเกตเบอร์ MC 14049 เพื่อขับ IGBT ทำงานเป็นสวิตช์

ข. การออกแบบวงจรควบคุมการทำงานของคอยล์จุดระเบิด

เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้ากระแสตรงที่จ่ายในวงจรสวิตช์กำเนิดคลื่นฮาร์มอนิกไปรบกวนภายนอกจำเป็นต้องใส่ EMI filter ไว้ทางเข้าของไฟฟ้ากระแสสลับที่หม้อแปลงไฟฟ้า  $T_1$  ซึ่งมีอัตรารอบ 2 : 1 ทำหน้าที่ลดศักดาไฟฟ้าทางออกจาก 220 V เป็น 110 V เพื่อให้คอยล์จุดระเบิดรถยนต์กำเนิดศักดาไฟฟ้าสูงประมาณ 20 kV ศักดาไฟฟ้าทางออกเมื่อผ่านวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์จะได้ไฟฟ้ากระแสตรงเต็มคลื่นซึ่งมีค่าสูงสุดของศักดาไฟฟ้าเท่ากับ  $10V \times \sqrt{2} = 154V$  กระแสในวงจรจะมีการประจุและคายประจุในวงจรคอยล์จุดระเบิดเครื่องยนต์จึงเลือกใช้ไดโอดเรียงกระแสที่ทนศักดาไฟฟ้าไบอัสกลับทาง 400 V ที่กระแส 15 A และเลือกใช้ IGBT ที่มี  $V_{CE} = 600 V$  และ  $I_C = 30 A$  เพื่อเพื่อความปลอดภัยไว้สูงกว่าพิกัดมาก

กระแสจากวงจรแหล่งจ่ายขณะที่ IGBT อยู่ในภาวะคายประจุหรือนำกระแสจะถูกจำกัดด้วยขดลวดเหนี่ยวนำ  $L_1$  เพื่อไม่ให้เกิดการลัดวงจร ขดลวด  $L_1$  นี้เลือกใช้บัลลาสต์หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดขนาด 18 W ซึ่งสามารถรับกระแสขณะจ่ายโหลดได้ 0.3 A และรับกระแสสูงสุดขณะลัดวงจรได้ 2.836 เท่าของกระแสปกติ<sup>[5]</sup> ดังนั้นวงจรกำเนิดศักดาไฟฟ้าสูงจึงสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

### 3.5.2 การออกแบบวงจรกำเนิดความถี่สูง

วงจรกำเนิดความถี่สูงใช้หม้อแปลงเทสลาโดยจูนความถี่เรโซแนนซ์อันดับ (series resonance) ที่ความถี่ 7 MHz จากการอาร์คของศักดาไฟฟ้าสูงที่กำเนิดจากคอยล์จุดระเบิดในเครื่องยนต์ผ่านสปาร์กแกป (spark gap) ซึ่งจะทำให้เกิดความถี่ฮาร์มอนิก (harmonic frequency) จากการอาร์ค วงจรจูนนี้เลือกค่า C เท่ากับ 50 pF คำนวณหาค่า L จากสูตรความถี่เรโซแนนซ์<sup>[6]</sup> ได้ดังนี้

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \dots\dots\dots 3.4$$

$$L = \frac{1}{(2\pi f)^2 C}$$

$$L = \frac{1}{(2\pi \times 7 \times 10^6)^2 50 \times 10^{-12}} = 10.34 \mu H$$

จากนั้นมาทำการคำนวณหาขนาดรัศมีและความยาวของขดลวดแกนอากาศโดยความสัมพันธ์ของค่า inductance จำนวนรอบ รัศมีและความยาวของขดลวดเป็นไปตามสมการที่



$$L = \frac{r^2 N^2}{9r + 10l} \dots\dots\dots 3.5$$

- โดยที่ L คือ inductance หน่วย  $\mu\text{H}$   
 N คือ จำนวนรอบขอบขดลวด  
 r คือ รัศมีของขดลวด หน่วยนิ้ว  
 l คือ ความยาวของขดลวด หน่วยนิ้ว

$$\text{ดังนั้น } N = \frac{\sqrt{L(9r + 10l)}}{r}$$

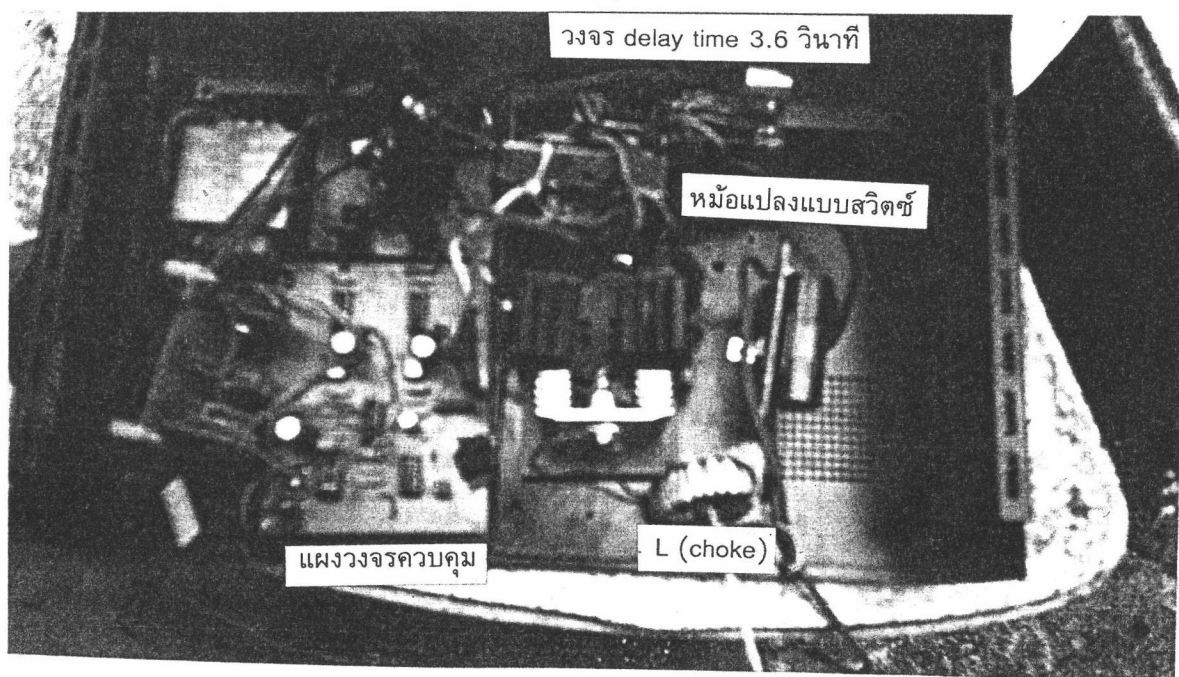
เลือกให้ รัศมีของขดลวด 1.5 นิ้ว และ ความยาวของขดลวด 3 นิ้ว

$$\text{ได้จำนวนรอบ } N = \frac{\sqrt{10.34(9(1.5) + 10(3))}}{1.5} = 14.1 \text{ รอบ}$$

ที่หม้อแปลงเทสลา  $T_3$  จะเลือก  $L_1 = 14$  รอบ กำหนดอัตรารอบ  $N_1 : N_2 = 2:1$  จะได้  $L_2$  มีจำนวนรอบ 7 รอบ ส่งความถี่สูงมายังหม้อแปลงส่งผ่านสัญญาณ  $T_4$  ซึ่งมีอัตรารอบ  $N_1 : N_2 = 2 : 1$  ขดทุติยภูมิของ  $T_2$  จะเป็นวงจรเรโซแนนซ์ขนาน (parallel resonance) เพื่อจูนความถี่จากคอยล์เทสลาโดยผ่าน  $R // C$  เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ชิ้นส่วนกิ่งตัวนำในวงจรจ่ายกระแสได้รับความถี่สูงไปรบกวน



รูปที่ 3.14 ภาพถ่ายเครื่องไมโครอาร์คพลาสมาที่พัฒนาขึ้น



รูปที่ 3.15 ภาพถ่ายภายในเครื่องไมโครอาร์คพลาสมา